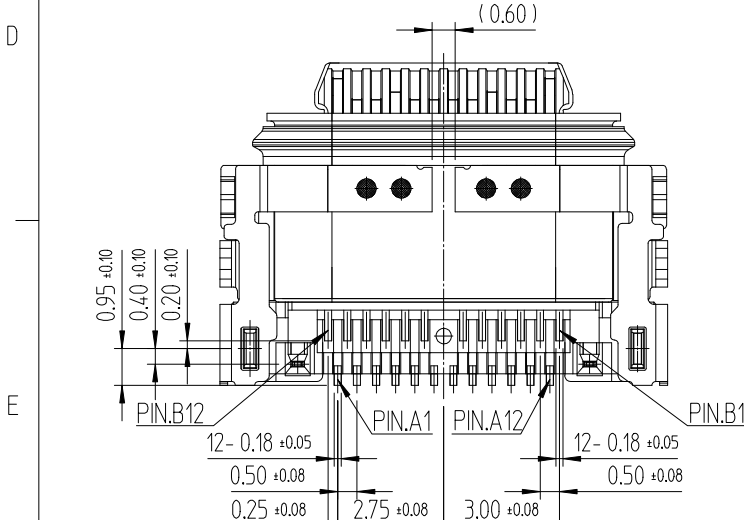
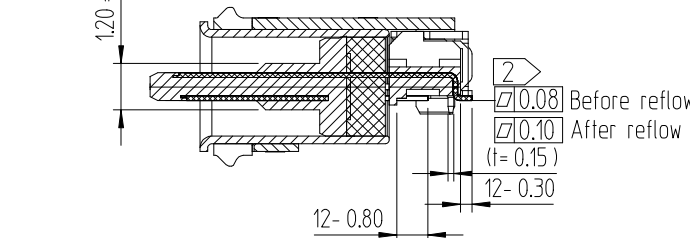
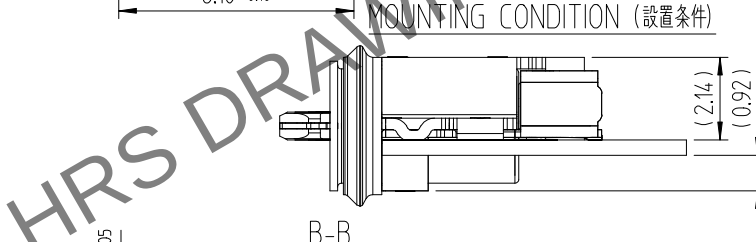
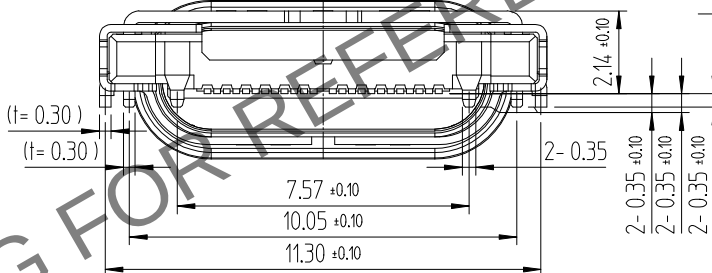
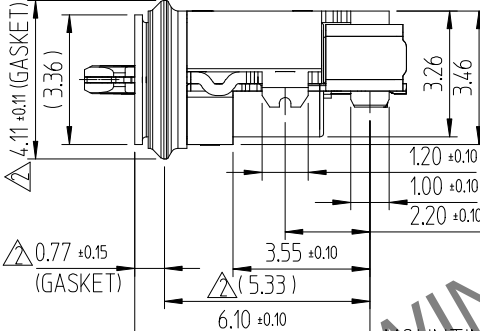
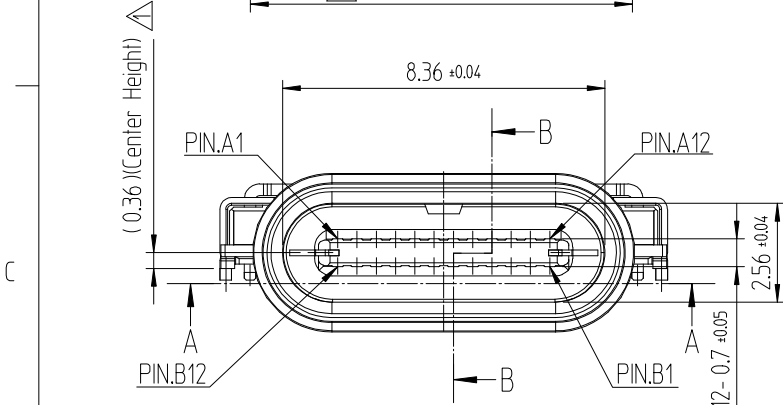
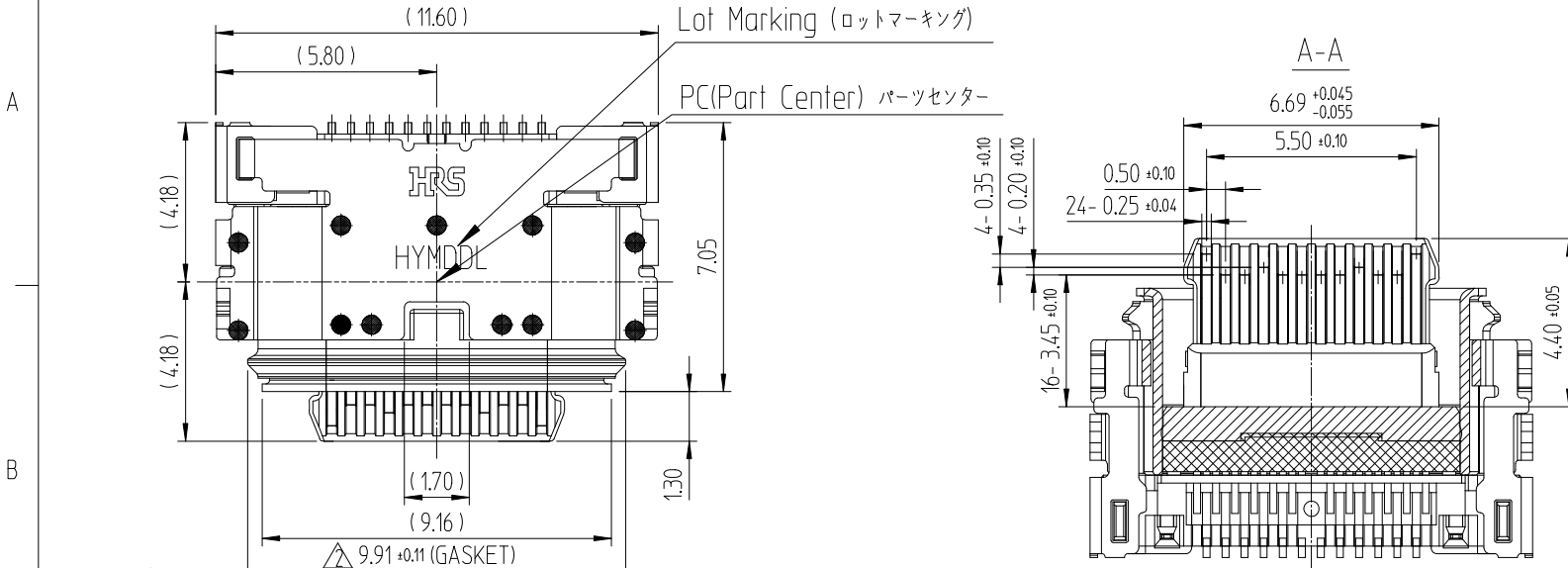
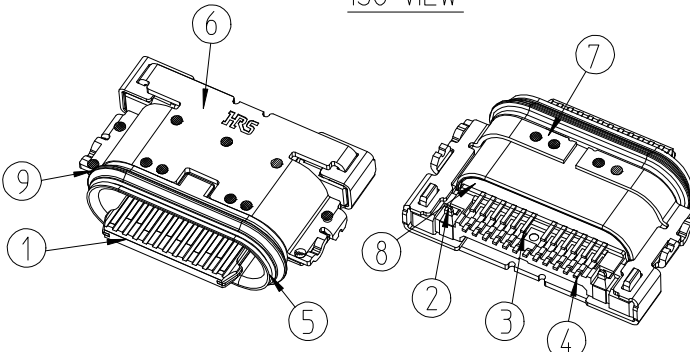


△數 COUNT	訂正事項 DESCRIPTION OF REVISIONS	擔當 B Y	檢圖 CHKD	年月日 DATE	△數 COUNT	訂正事項 DESCRIPTION OF REVISIONS	擔當 B Y	檢圖 CHKD	年月日 DATE
①	1 改正	LSH	LHJ	20. 02. 18	△				. .
②	13 改正(RE-2-1828)	LSH	LHJ	20. 03. 03	△				. .
③	2 改正(RE-2-2059)	KYG	LHJ	22. 12. 06	△				. .

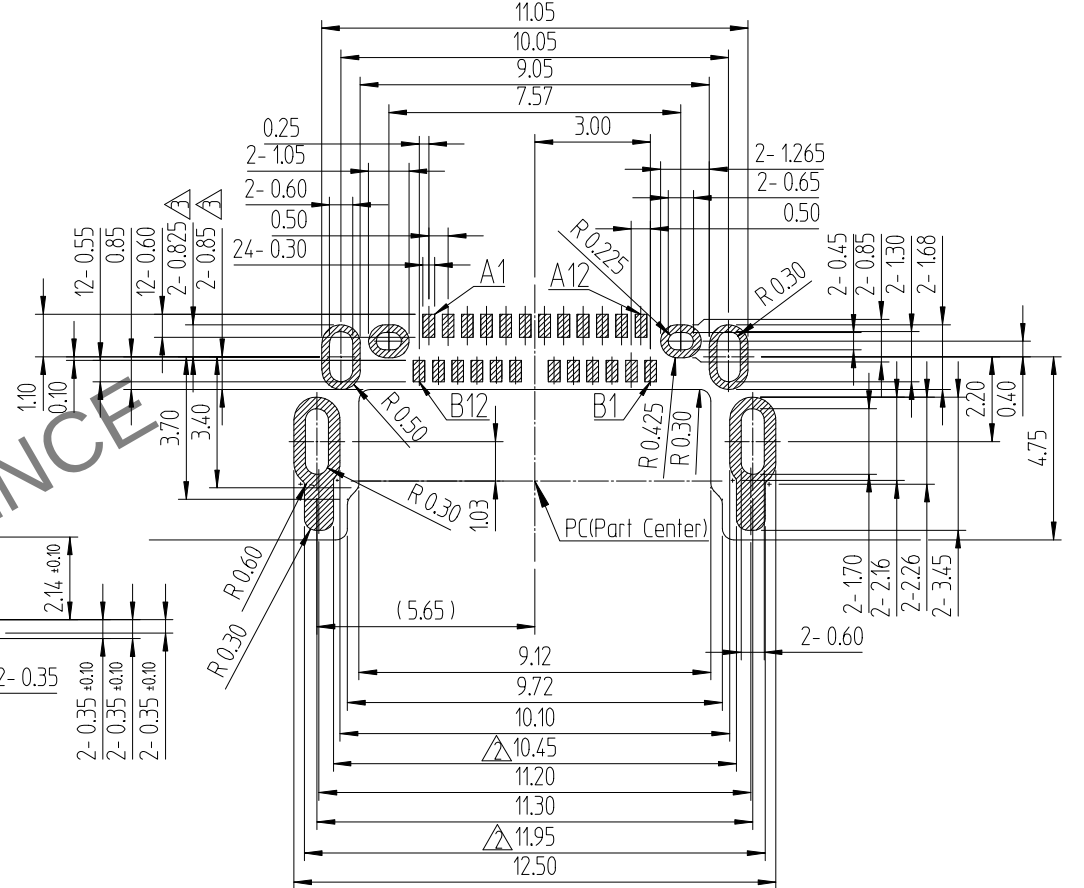


[NOTE] [注]

1	FINISH : SEE TABLE (仕上げ : テーブル参照)
2	CO-PLANARITY : 0.08 MAX before reflow 0.10 MAX after reflow 2times (平坦度 : REFLOW前0.08 MAX / REFLOW2回後0.10 MAX)
3	UNSPECIFIED TOLERANCE : ± 0.2 (一般公差 : ± 0.2)
4	LOT Marking : 6 digits (HYMDDL) (LOT マーキング : 6 桁(HYMDDL))



RECOMMENDED PCB LAY OUT(TOP-VIEW) 推奨PCBレイアウト上面図
(GENERAL TOLERANCE±0.05) (一般公差 : ±0.05)



9	Gasket (ガスケット)	SILICONE (シリコン)	GRAY COLOR (灰色)	-
8	POTTING (ポッティング)	SILICONE (シリコン)	BLACK COLOR (黒色)	-
7	BOTTOM SHELL (ボトムシェル)	STAINLESS STEEL(ステンレス鋼)	Ni1.0μm MIN (ニッケル1.0μm MIN)	-
6	TOP SHELL (トップシェル)	STAINLESS STEEL(ステンレス鋼)	Ni1.0μm MIN (ニッケル1.0μm MIN)	-
5	INNER SHELL (INNER シェル)	STAINLESS STEEL(ステンレス鋼)	Cleansing (洗浄)	-
4	CONTACT 2nd (端子 2nd)	COPPER ALLOY(銅合金)	Contact Area : Au0.05μm Min over Pd-Ni0.75μm Min over Ni2.0μm Min Solder Tails : Au0.05μm Min over Ni2.0μm Min	-
3	CONTACT 1st (端子1st)		接触面積 : ニッケル2.0μm 以上 + パラジウムニッケル0.75μm 以上 + 金0.05μm 以上 リード面積 : ニッケル2.0μm 以上 + 金0.05μm 以上	-
2	MID PLATE (ミッドプレート)	STAINLESS STEEL(ステンレス鋼)	Ni1.0μm MIN (ニッケル1.0μm MIN)	-
1	HOUSING (ハウジング)	THERMOPLASTIC(耐熱プラスチック)	BLACK COLOR (黒色)	-
NO.(番号)	DESCRIPTIONS (説明)	MATERIAL (材料)	① FINISH. (備考)	REMARKS(備考)
CODE NO. (OLD) 製品コード		DRAWN 製 図 M.C.PAEK 19.09.20	DESIGNED 設 計 M.C.PAEK 19.09.20	CHECKED 検 図 H.J.LEE 19.09.20
		APPROVED 承 認 H.J.LEE 19.09.20	RELEASED 出 図 ENG 22.12.06 DEPT	
	DRAWING NO. (図面番号)		PART NO. (製品名)	
SCALE 5:1	JDC3-632671		CX90MWD2G-24P	
UNITS mm	HRS HIROSE KOREA CO.,LTD.		CODE NO (製品コード)	
			CL 6240-0022-9	
			1/2	

Apr. 1. 2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

